

S-8209B系列的使用示例

Rev.1.5_01

© SII Semiconductor Corporation, 2008-2015

S-8209B系列是带电量均衡功能的电池保护用IC。

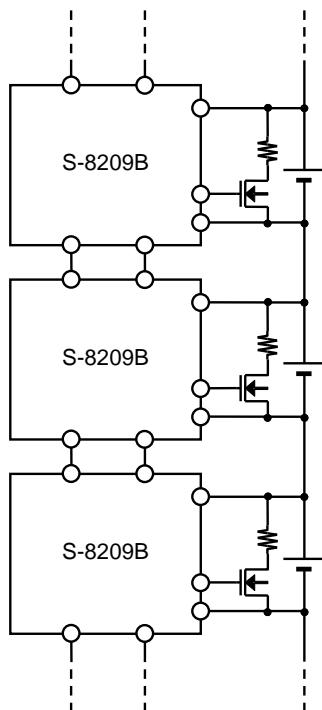
本应用手册是说明有关使用S-8209B系列的具有代表性的电路连接示例的参考资料。

有关产品的详情与规格，请确认该产品的数据表。

使用S-8209B系列可构成以下应用电路。

- 2节以上的多节电池串联保护电路
- 带电量均衡功能的电池保护电路

• 使用S-8209B系列的多节电池串联保护电路



目 录

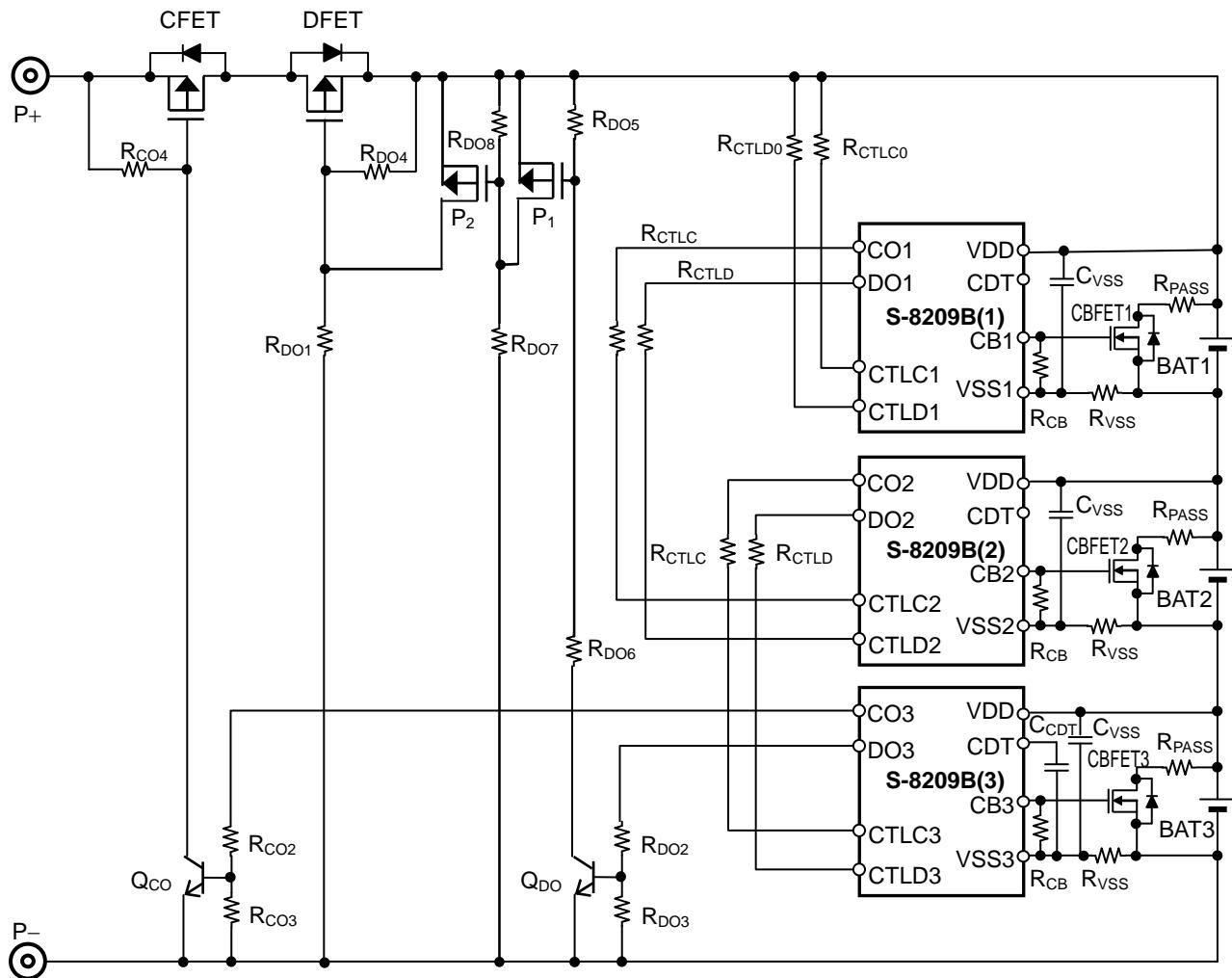
1. 使用S-8209B系列 (无放电电量均衡功能) 的多节电池串联保护电路	3
1. 1 电池保护IC的连接示例	3
1. 2 工作说明	4
1. 2. 1 通常状态	4
1. 2. 2 禁止充电状态	5
1. 2. 3 禁止放电状态	6
1. 2. 4 充电电量均衡功能	7
1. 2. 5 延迟电路	7
1. 3 时序图	8
1. 3. 1 过充电检测	8
1. 3. 2 过放电检测	9
1. 4 检测充电电量均衡的实际数据	10
1. 4. 1 在充电电流的旁路电流比率较高时	10
1. 4. 2 在充电电流的旁路电流比率较低时	11
2. 使用S-8209B系列 (有放电电量均衡功能) 的多节电池串联保护电路	12
2. 1 电池保护IC的连接示例	12
2. 2 工作说明	13
2. 3 过放电检测的时序图	14
2. 4 检测过放电电量均衡的实际数据	15
3. 应用电路示例	16
4. 外接元器件一览	17
5. 注意事项	18
6. 相关资料	18

1. 使用S-8209B系列(无放电电量均衡功能)的多节电池串联保护电路

S-8209B系列可以通过将CTL_C、CTL_D端子与其他的S-8209B系列的CO、DO端子相连，构成多个串联连接电池的保护电路。

1.1 电池保护IC的连接示例

图1表示使用S-8209B系列的多节电池串联保护电路示例。



备注 关于各外接元器件的参数，请参阅“4. 外接元器件一览”。

图1

- 注意1. 上述参数有可能未经预告而更改。
- 2. 上述连接图以及参数仅供参考，并不作为保证工作的依据。请在进行充分的评价基础上设定实际的应用电路的参数。

1. 2 工作说明

在此说明图1中的使用S-8209B系列的多节电池串联保护电路示例的工作。

1. 2. 1 通常状态

以下对通常状态下的工作进行说明。

由于CTLC1、CTLD1端子分别被上拉至VDD1端子电位，因此当BAT1高于过放电检测电压(V_{DL})且低于过充电检测电压(V_{CU})时，S-8209B (1)变为通常状态。CO1、DO1端子均变为VDD1端子电位。

由于CTLC2、CTLD2端子分别通过CO1、DO1端子被上拉至VDD1端子电位，因此当BAT2高于 V_{DL} 且低于 V_{CU} 时，S-8209B (2)变为通常状态。CO2、DO2端子均变为VDD2端子电位。

由于CTLC3、CTLD3端子分别通过CO2、DO2端子被上拉至VDD2端子电位，因此当BAT3高于 V_{DL} 且低于 V_{CU} 时，S-8209B (3)变为通常状态。CO3、DO3端子均变为VDD3端子电位。

通常状态下各端子的状态如表1所示。

表1

CTLC端子	CTLD端子	电池的状态	CO端子	DO端子
CTLC1 = VDD1	CTLD1 = VDD1	$V_{DL} < BAT1 < V_{CU}$	CO1 = VDD1	DO1 = VDD1
CTLC2 = VDD1	CTLD2 = VDD1	$V_{DL} < BAT2 < V_{CU}$	CO2 = VDD2	DO2 = VDD2
CTLC3 = VDD2	CTLD3 = VDD2	$V_{DL} < BAT3 < V_{CU}$	CO3 = VDD3	DO3 = VDD3

通常状态下的S-8209B (3)通过外接在CO3、DO3端子上的晶体管(Q_{CO} , Q_{DO} , P_1 , P_2)，使充电控制用FET(CFET)、放电控制用FET(DFET)均变为“ON”。

因此，可以通过连接在P+—P-之间的充电器或负载进行充放电。

1. 2. 2 禁止充电状态

以下以S-8209B (1)检测到过充电，S-8209B (2)、(3)处于通常状态时为例，对禁止充电状态的工作进行说明。

由于充电当 $BAT_1 \geq V_{CU}$ 时，S-8209B (1)变为过充电状态，CO1端子变为高阻抗状态。

S-8209B (2)的CTLC2端子通过CTLC端子源极电流(I_{CTLC})被VSS2端子下拉。因CO1端子处于高阻抗状态，所以CTLC2端子也随之变为VSS2端子电位。因此，当CTLC2端子电位 $\leq V_{CTLCL}$ 时，S-8209B (2)也变为过充电状态，CO2端子变为高阻抗状态。

同样，S-8209B (3)的CTLC3端子通过 I_{CTLC} 被VSS3端子下拉。因CO2端子处于高阻抗状态，所以CTLC3端子也随之变为VSS3端子电位。因此，当CTLC3端子电位 $\leq V_{CTLCL}$ 时，S-8209B (3)也变为过充电状态。

在这种情况下的各端子的状态如表2所示。

表2

CTLC端子	CTLD端子	电池的状态	CO端子	DO端子
CTLC1 = VDD1	CTLD1 = VDD1	$V_{CU} \leq BAT_1$	CO1 = High-Z	DO1 = VDD1
CTLC2 = VSS2	CTLD2 = VDD1	$V_{DL} < BAT_2 < V_{CU}$	CO2 = High-Z	DO2 = VDD2
CTLC3 = VSS3	CTLD3 = VDD2	$V_{DL} < BAT_3 < V_{CU}$	CO3 = High-Z	DO3 = VDD3

过充电状态的S-8209B (3)通过外接在CO3端子上的双极晶体管(Q_{CO})使CFET变为“OFF”。在这种情况下，禁止通过连接在P+—P-之间的充电器进行充电。

进行如上所述的工作后，可经由CO端子—CTLC端子进行通信，将过充电状态从上段(S-8209B (1))传送到下段(S-8209B (3))。

当 BAT_2 或 $BAT_3 \geq V_{CU}$ 时，也同样禁止进行充电。

1. 2. 3 禁止放电状态

以下以S-8209B (1) 检测到过放电，S-8209B(2)、(3)处于通常状态时为例，对禁止放电状态的工作进行说明。

由于放电当 $BAT1 \leq V_{DL}$ 时，S-8209B (1)变为过放电状态，DO1端子变为高阻抗状态。

S-8209B (2)的CTL2端子通过CTL2端子吸收电流(I_{CTL2L})被VSS2端子下拉。因DO1端子处于高阻抗状态，所以CTL2端子也随之变为VSS2端子电位。因此，当CTL2端子电位 \leq CTL2端子L电压(V_{CTL2L})时，S-8209B (2)也变为过放电状态，DO2端子变为高阻抗状态。

同样，S-8209B (3)的CTL3端子通过CTL3端子吸收电流(I_{CTL3L})被VSS3端子下拉。因DO2端子处于高阻抗状态，所以CTL3端子也随之变为VSS3端子电位。因此，当CTL3端子电位 $\leq V_{CTL3L}$ 时，S-8209B (3)也变为过放电状态。

在这种情况下的各端子的状态如表3所示。

表3

CTLC端子	CTL2端子	电池的状态	CO端子	DO端子
CTLC1 = VDD1	CTL21 = VDD1	$BAT1 \leq V_{DL}$	CO1 = VDD1	DO1 = High-Z
CTLC2 = VDD1	CTL22 = VSS2	$V_{DL} < BAT2 < V_{CU}$	CO2 = VDD2	DO2 = High-Z
CTLC3 = VDD2	CTL23 = VSS3	$V_{DL} < BAT3 < V_{CU}$	CO3 = VDD3	DO3 = High-Z

过放电状态的S-8209B (3)通过外接在DO3端子上的晶体管(Q_{DO} , P_1 , P_2)使DFET变为“OFF”。在这种情况下，禁止通过连接在 P_+ — P_- 之间的负载进行放电。

进行如上所述的工作后，可经由DO端子—CTL端子进行通信，将过放电状态从上段(S-8209B (1))传送到下段(S-8209B (3))。

当 $BAT2$ 或 $BAT3 \leq V_{DL}$ 时，也同样禁止进行放电。

1.2.4 充电电量均衡功能

在图1中，通过充电，当BAT1 \geq 电量均衡检测电压(V_{BU})时，S-8209B (1)的CB1端子变为VDD1端子电位。经此工作，电量均衡控制用FET(CBFET1)变为“ON”，通过电量均衡控制用FET对流入BAT1的充电电流进行旁路。这时，如果BAT2、BAT3低于 V_{BU} ，与BAT2、BAT3的充电速度相比，则BAT1的充电速度显得相对平稳。这称为充电电量均衡功能。不论哪个电池的电压达到 V_{BU} ，各自相对应的电量均衡控制用FET会变为“ON”，从而调整好电量均衡。

另外，通过放电，电池电压再次下降到电量均衡解除电压(V_{BL})以下时，S-8209B系列会使电量均衡控制用FET变为“OFF”。

注意 组装如图1所示的保护电路时，在含有电压 $\geq V_{BL}$ 电池的情况下，电池连接后，电量均衡控制用FET有可能变为“ON”。

1.2.5 延迟电路

如图1所示，仅在S-8209B (3)的CDT3端子上连接延迟电容时，无论哪个电池进行检测，均可以获得几乎相同的检测延迟时间(t_{DET})和解除延迟时间(t_{REL})。

(1) 检测延迟时间 (t_{DET})

通过充电，当BAT1 $\geq V_{CU}$ 时，由于CDT1端子上没有连接电容，经数百μs左右的延迟时间后，CO1端子变为高阻抗状态，CTL2端子变为VSS2端子电位。

同样，当CTL2端子电位 $\leq V_{CTL1}$ 时，经数百μs左右的延迟时间后，S-8209B (2)的CO2端子变为高阻抗状态。由于S-8209B (3)的CDT3端子上连接有 C_{CDT} ，经 $10.0 [M\Omega] (\text{典型值}) \times 0.01 [\mu F] = 0.1 [s] (\text{典型值})$ 的延迟时间后，CO3端子变为高阻抗状态。

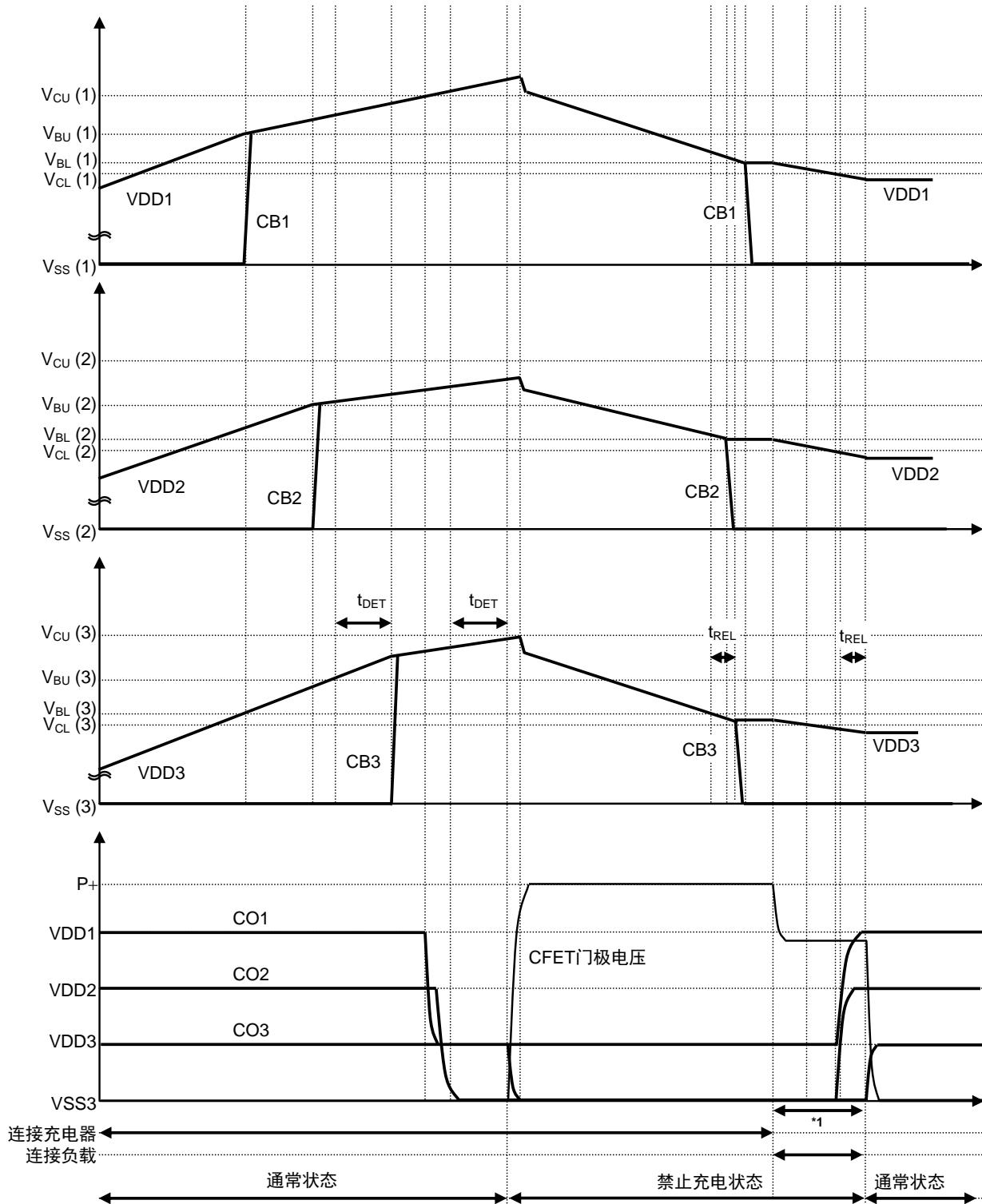
进行如上所述的工作后，由于整体的延迟时间可根据S-8209B (3)的延迟时间来确定，因此，无论哪个电池进行检测，均可以获得几乎相同的检测延迟时间。

(2) 解除延迟时间 (t_{REL})

S-8209B系列也备有解除延迟时间(t_{REL})，可将解除延迟时间设定为检测延迟时间的约10分之1。和检测延迟时间一样，当仅在S-8209B (3)的CDT3端子上连接延迟电容时，可获得几乎相同的解除延迟时间。

1.3 时序图

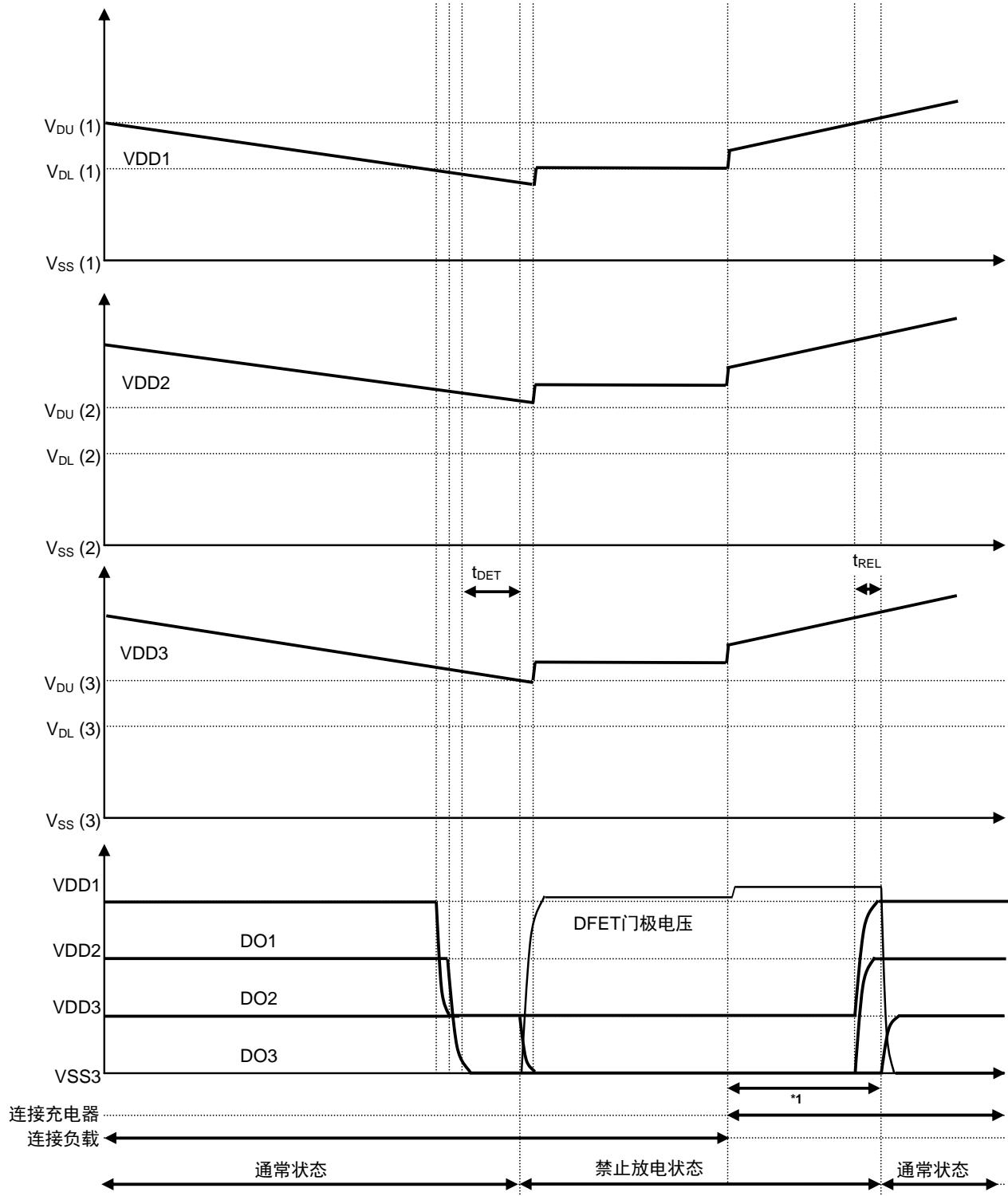
1.3.1 过充电检测



*1. 在此期间内，放电电流可经由CFET的寄生二极管流入。

图2

1.3.2 过放电检测



*1. 在此期间内，充电电流可经由DFET的寄生二极管流入。

图3

1.4 检测充电电量均衡的实际数据

利用S-8209BAA，通过3节串联锂离子可充电电池来显示电量均衡的实际数据。

1.4.1 在充电电流的旁路电流比率较高时

充电器：恒定电流充电器 ($0.05 \text{ C} = 145 \text{ mA}$)

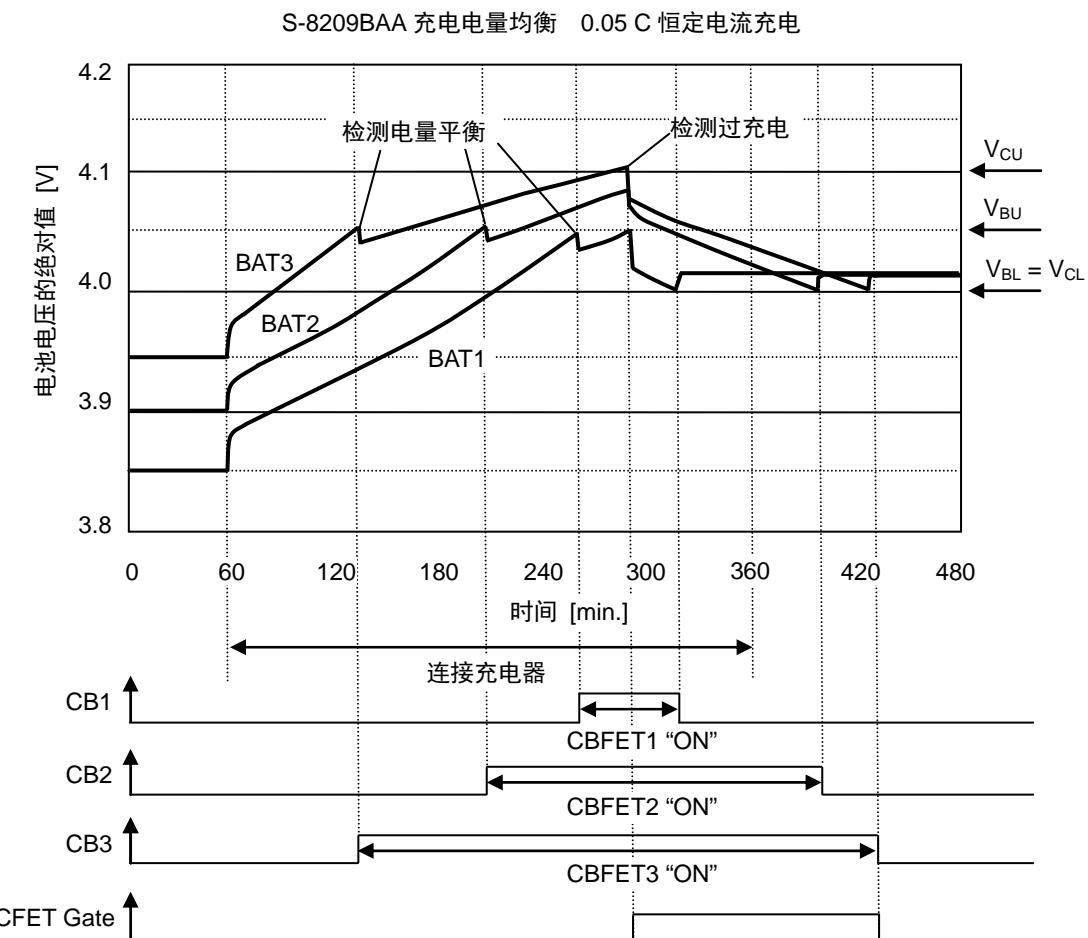


图4

测定条件

测定电路；图1

IC; S-8209BAA ($V_{CU} = 4.100 \text{ V}$, $V_{CL} = 4.000 \text{ V}$, $V_{BU} = 4.050 \text{ V}$, $V_{BL} = 4.000 \text{ V}$, $V_{DL} = 2.500 \text{ V}$, $V_{DU} = 2.700 \text{ V}$)

电池：3节串联锂离子可充电电池 公称容量：2.9 Ah 尺寸：18650

$R_{PASS} = 51 \Omega$ (1 W) \rightarrow 旁路电流 = $4.1 \text{ V} / 51 \Omega = 80 \text{ mA}$

1.4.2 在充电电流的旁路电流比率较低时

在充电电流的旁路电流比率较低时，通过数次重复电量均衡周期，可以实现电量均衡。

充电器：恒定电流充电器 ($0.1 \text{ C} = 290 \text{ mA}$)

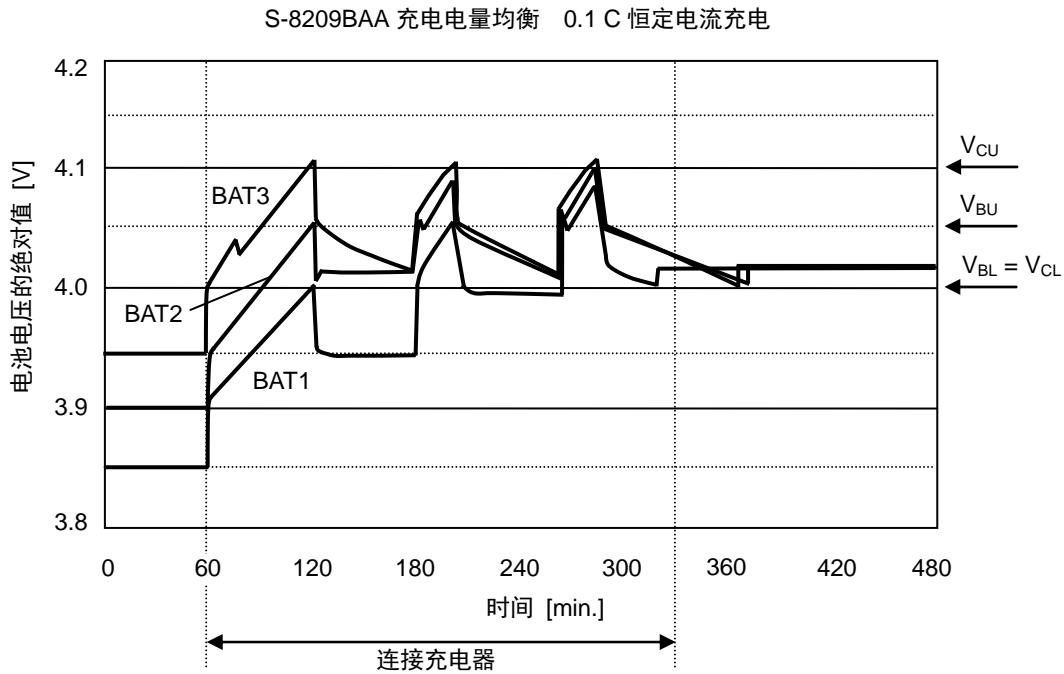


图5

测定条件

测定电路：图1

IC：S-8209BAA ($V_{CU} = 4.100 \text{ V}$, $V_{CL} = 4.000 \text{ V}$, $V_{BU} = 4.050 \text{ V}$, $V_{BL} = 4.000 \text{ V}$, $V_{DL} = 2.500 \text{ V}$, $V_{DU} = 2.700 \text{ V}$)

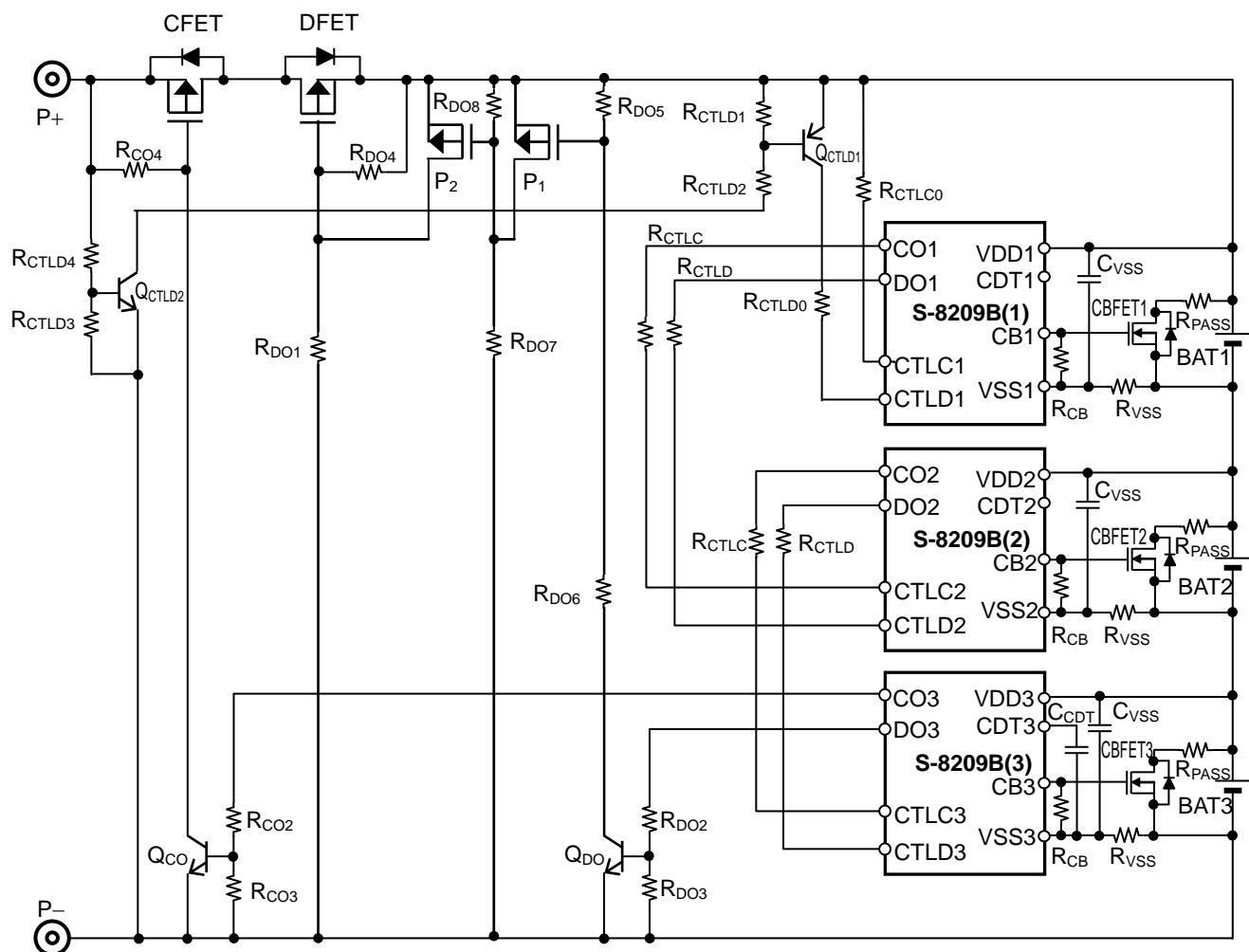
电池：3节串联锂离子可充电电池 公称容量：2.9 Ah 尺寸：18650

$R_{PASS} = 51 \Omega$ (1 W) \rightarrow 旁路电流 = $4.1 \text{ V} / 51 \Omega = 80 \text{ mA}$

2. 使用S-8209B系列(有放电电量均衡功能)的多节电池串联保护电路

2.1 电池保护IC的连接示例

通过添加双极晶体管(Q_{CTLD1} , Q_{CTLD2})，可增加从最下段(S-8209B (3))传送到最上段(S-8209B (1))的过放电状态通信功能。



备注 关于各外接元器件的参数，请参阅“4. 外接元器件一览”。

图6

- 注意1. 上述参数有可能未经预告而更改。
2. 上述连接图以及参数仅供参考，并不作为保证工作的依据。请在进行充分的评价基础上设定实际的应用电路的参数。

2. 2 工作说明

在此说明图6的使用S-8209B系列的多节电池串联保护电路例的工作。

通过在图6的电路中添加的双极晶体管(Q_{CTLD1} , Q_{CTLD2})，可增加从最下段(S-8209B (3))至最上段(S-8209B (1))的过放电状态通信功能。借此，即使S-8209B (1)~(3)的任意一方最初处于过放电状态，由于可以使其他所有的S-8209B系列的电量均衡控制用FET(CBFET)变为“ON”，因此可确实地调整好电量均衡。

以下以S-8209B (2)检测到过放电、S-8209B (1)、(3)处于通常状态时为例，说明一下禁止放电状态的工作。

1. 由于放电当 $BAT2 \leq V_{DL}$ 时，S-8209B (2)变为过放电状态、DO2端子变为高阻抗状态。
2. 通过DO2端子-CTLD3端子，S-8209B (3)也变为过放电状态。
3. 利用放电电量均衡功能，S-8209B (3)把电量均衡控制用FET(CBFET3)设置为“ON”。
4. 过放电状态的S-8209B (3)通过晶体管(Q_{DO} P₁, P₂)使DFET变为“OFF”，禁止向P₊-P₋之间所连接的负载放电。
5. 由于P₊-P₋之间所连接的负载，P₊端子被下拉。
6. Q_{CTLD1} , Q_{CTLD2} 均变为“OFF”，S-8209B (1)的CTLD1端子变为高阻抗状态。
7. S-8209B (1)也变为过放电状态，利用放电电量均衡功能使电量均衡控制用FET(CBFET1)变为“ON”。

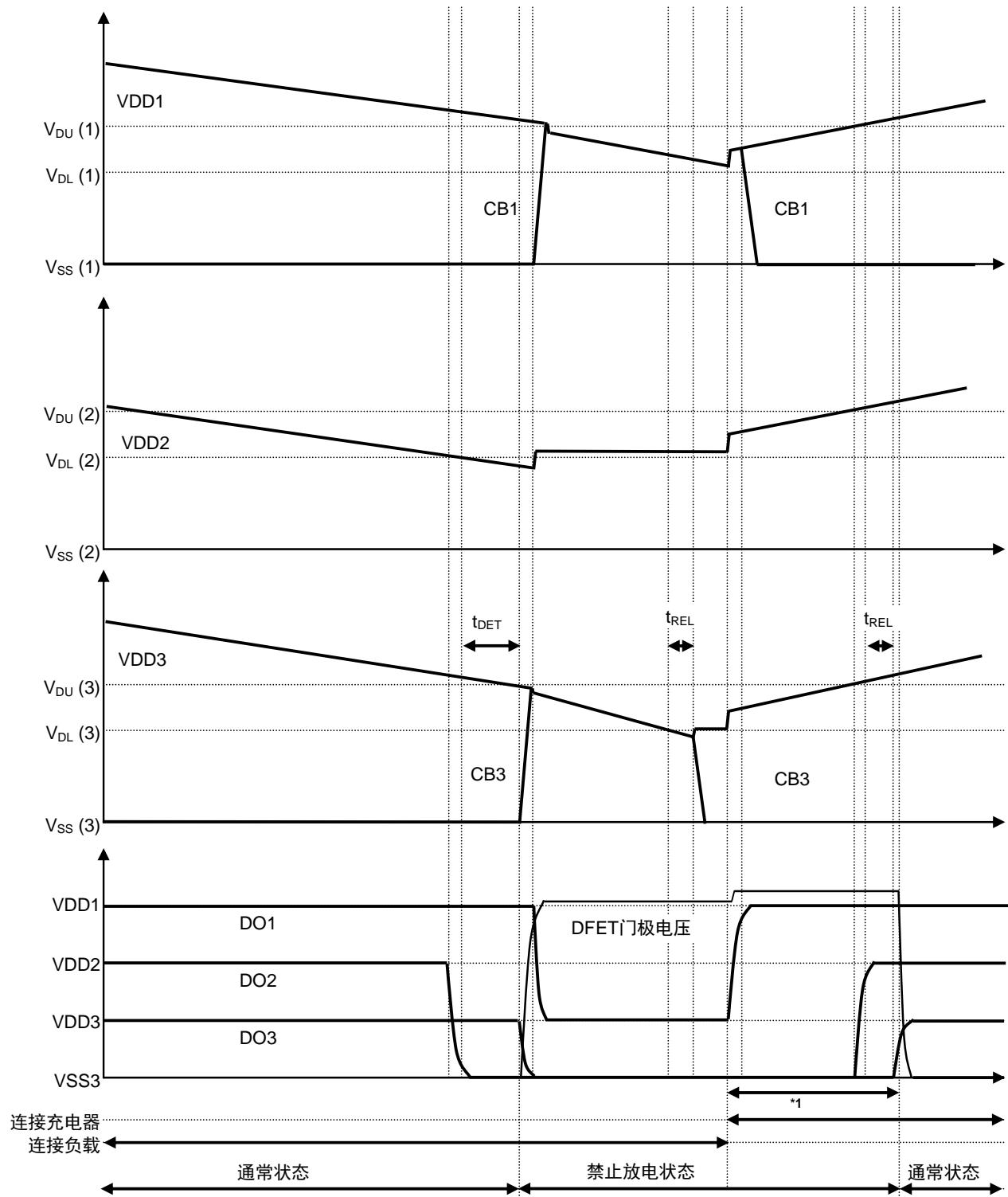
进行如上所述的工作后，由于BAT2的电压下降，即使在S-8209B (2)最初检测到过放电的情况下，也可以通过 Q_{CTLD1} , Q_{CTLD2} 进行通信，将过放电状态从S-8209B (3)传送到S-8209B (1)，其结果是S-8209B (1)~(3)的所有端子均转变为过放电状态，当各BAT均高于 V_{DL} 时，通过放电电量均衡功能调整好电量均衡。

当BAT1~3的电压下降到 $\leq V_{DL}$ 时，各自的电量均衡控制用FET变为“OFF”。

另外，禁止放电后，在P₊-P₋之间连接充电器时， Q_{CTLD1} , Q_{CTLD2} 变为“ON”，CTLD1端子会被上拉至VDD1端子电位。因此，即使BAT1的电压尚未下降到 $\leq V_{DL}$ ，S-8209B (1)的电量均衡控制FET(CBFET1)也会变为“OFF”。

注意 组装如图6所示的保护电路时，在没有电压 $\geq V_{BL}$ 或电压 \leq 过放电解除电压(V_{DU})的电池的情况下，电池连接后，电量均衡控制用FET有可能变为“ON”。此时，只要在P₊-P₋之间连接充电器，电量均衡控制用FET就会变为“OFF”。

2.3 过放电检测的时序图



*1. 在此期间内，充电电流可经由DFET的寄生二极管流入。

图7

2. 4 检测过放电电量均衡的实际数据

利用S-8209BAA，通过3节串联锂离子可充电电池来显示电量均衡的实际数据。

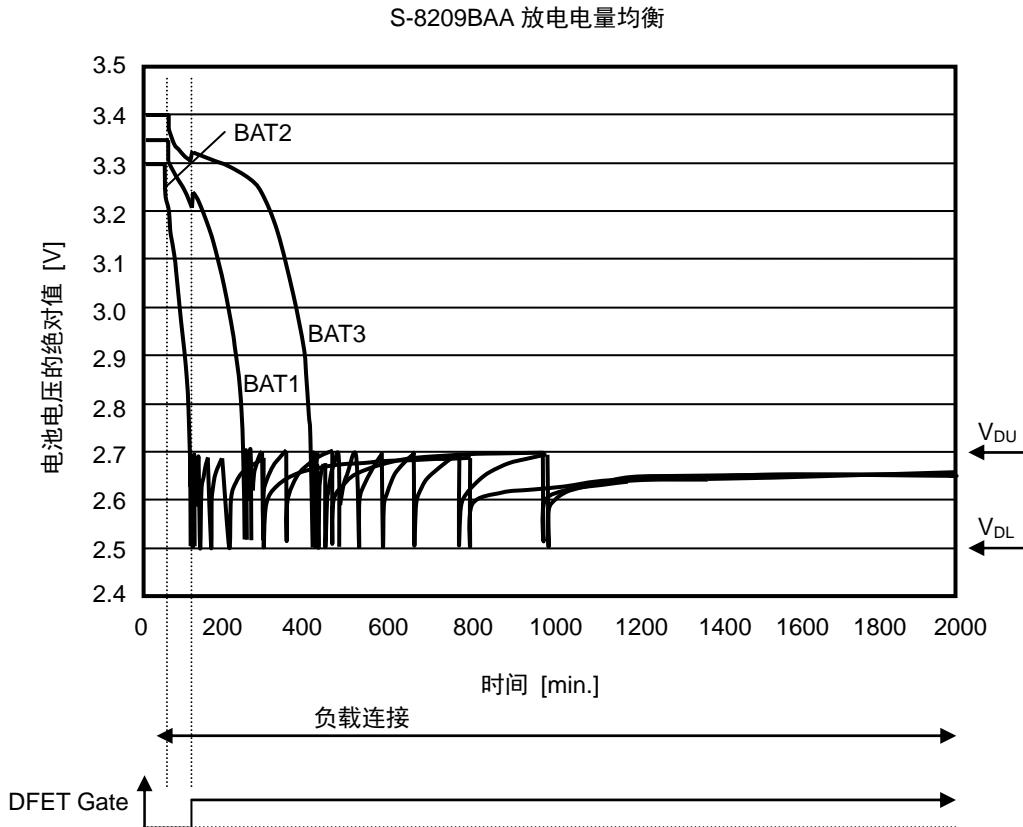


图8

测定条件

测定电路；图6

IC: S-8209BAA ($V_{CU} = 4.100 \text{ V}$, $V_{CL} = 4.000 \text{ V}$, $V_{BU} = 4.050 \text{ V}$, $V_{BL} = 4.000 \text{ V}$, $V_{DL} = 2.500 \text{ V}$, $V_{DU} = 2.700 \text{ V}$)

电池: 3节串联锂离子可充电电池 公称容量: 2.9 Ah 尺寸: 18650

$R_{PASS} = 51 \Omega$ (1 W) → 旁路电流 = $2.5 \text{ V} / 51 \Omega = 49 \text{ mA}$

负载: 100 Ω

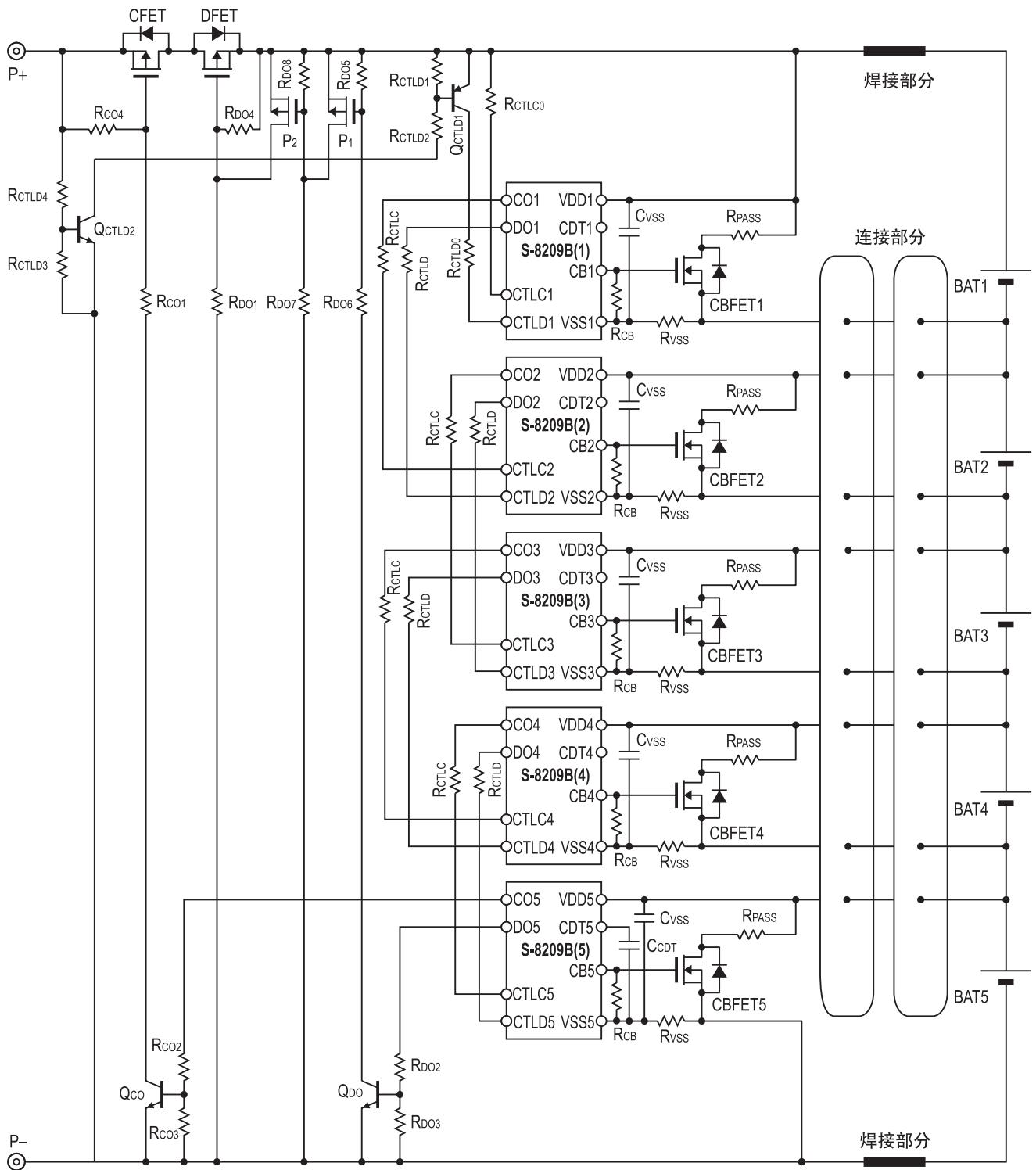
关于电池电压的振荡

1. 当电池电压下降到过放电检测电压(V_{DL})以下时，电量均衡控制用FET变为“OFF”。
2. 由于通过电量均衡控制用FET的放电停止，致使电池电压上升。
3. 当电池电压上升到过放电解除电压(V_{DU})以上时，电量均衡控制用FET变为“ON”。
4. 由于通过电量均衡控制用FET的放电开始，致使电池电压下降。

通过上述1-4的反复操作来调整电量均衡。

S-8209B系列的使用示例**3. 应用电路示例**

按照以下应用电路，通过连接部分把中间端子连接起来使用时，即使中间端子断线，充放电都会停止，从而能提高产品的安全性能。



备注 关于各外接元器件的参数，请参阅“4. 外接元器件一览”。

图9

4. 外接元器件一览

表4中是图1、图6、图9的连接示例中的各个外接元器件。

表4

符号	典型值	单位	元器件名件	厂家	备注
CBFET1 ~ CBFET5	—	—	—	—	用户自行设定
CFET	—	—	—	—	用户自行设定
DFET	—	—	—	—	用户自行设定
C _{CDT}	—	—	—	—	用户自行设定
C _{VSS}	0.1	μF	GRM188	株式会社村田制作所	推荐
P ₁	—	—	2SJ210C	瑞萨电子株式会社	推荐
P ₂	—	—	2SJ210C	瑞萨电子株式会社	推荐
Q _{CTL01}	—	—	2SA1037AK	ROHM半导体集团	推荐
Q _{CTL02}	—	—	2SC2412K	ROHM半导体集团	推荐
Q _{CO}	—	—	2SC2412K	ROHM半导体集团	推荐
Q _{DO}	—	—	2SC2412K	ROHM半导体集团	推荐
R _{CB}	10	MΩ	MCR03	ROHM半导体集团	推荐
R _{CO1}	1	MΩ	MCR03	ROHM半导体集团	推荐
R _{CO2}	510	kΩ	MCR03	ROHM半导体集团	推荐
R _{CO3}	1	MΩ	MCR03	ROHM半导体集团	推荐
R _{CO4}	1	MΩ	MCR03	ROHM半导体集团	推荐
R _{CTLC} ^{*1}	1	kΩ	MCR03	ROHM半导体集团	推荐
R _{CTLC0}	1	kΩ	MCR03	ROHM半导体集团	推荐
R _{CTL0} ^{*1}	1	kΩ	MCR03	ROHM半导体集团	推荐
R _{CTL00}	1	kΩ	MCR03	ROHM半导体集团	推荐
R _{CTL01}	1	MΩ	MCR03	ROHM半导体集团	推荐
R _{CTL02}	4.7	MΩ	MCR03	ROHM半导体集团	推荐
R _{CTL03}	1	MΩ	MCR03	ROHM半导体集团	推荐
R _{CTL04}	4.7	MΩ	MCR03	ROHM半导体集团	推荐
R _{DO1}	1	MΩ	MCR03	ROHM半导体集团	推荐
R _{DO2}	510	kΩ	MCR03	ROHM半导体集团	推荐
R _{DO3}	1	MΩ	MCR03	ROHM半导体集团	推荐
R _{DO4}	1	MΩ	MCR03	ROHM半导体集团	推荐
R _{DO5}	1	MΩ	MCR03	ROHM半导体集团	推荐
R _{DO6}	1	MΩ	MCR03	ROHM半导体集团	推荐
R _{DO7}	1	MΩ	MCR03	ROHM半导体集团	推荐
R _{DO8}	1	MΩ	MCR03	ROHM半导体集团	推荐
R _{PASS} ^{*2}	—	—	—	—	用户自行设定
R _{VSS}	470	Ω	MCR03	ROHM半导体集团	推荐

*1. 为了防止在施加过大电压时IC的破损, 请在0 Ω ~ 100 kΩ范围选择R_{CTLC}, R_{CTL0}。

*2. 请注意额定功率。

注意1. 上述参数有可能未经预告而更改。

2. 上述连接图以及参数仅供参考, 并不作为保证工作的依据。请在进行充分的评价基础上设定实际的应用电路的参数。
3. 组成5节以上的串联保护电路时, 在选择时请注意外接元器件的耐压情况。

5. 注意事项

- 本资料中所登载的应用电路示例，是本公司IC产品中具有代表性的应用示例。在使用之前，务请进行充分的测试。
- 利用本资料中所记载的应用电路进行批量设计生产时，务请注意外接元部件的偏差及其的温度特性。另外，有关登载电路的专利问题，本公司概不承担相应责任。
- 使用本公司的IC生产产品时，如因其产品中对该IC的使用方法或产品的规格、或因进口国等原因，使包括本IC产品在内的制品发生专利纠纷时，本公司概不承担相应责任。

6. 相关资料

有关S-8209B系列的详情，请参阅如下的数据表。

S-8209B系列 数据表

本应用手册及数据表的内容，有可能未经预告而更改。

有关详情，请向本公司营业部咨询。

最新版本请在本公司Web网站上选择产品分类和产品名称，下载PDF文件。

www.sii-ic.com SII Semiconductor Corporation Web网站

免责事项 (使用注意事项)

1. 本资料记载的所有信息 (产品数据、规格、图、表、程序、算法、应用电路示例等) 是本资料公开时的最新信息，有可能未经预告而更改。
2. 本资料记载的电路示例、使用方法仅供参考，并非保证批量生产的设计。
使用本资料的信息后，发生并非因产品而造成的损害，或是发生对第三方知识产权等权利侵犯情况，本公司对此概不承担任何责任。
3. 因本资料记载的内容有说明错误而导致的损害，本公司对此概不承担任何责任。
4. 请注意在本资料记载的条件范围内使用产品，特别请注意绝对最大额定值、工作电压范围和电气特性等。
因在本资料记载的条件范围外使用产品而造成的故障和(或)事故等的损害，本公司对此概不承担任何责任。
5. 在使用本资料记载的产品时，请确认使用国家、地区以及用途的法律、法规，测试产品用途的满足能力和安全性能。
6. 本资料记载的产品出口海外时，请遵守外汇交易及外国贸易法等的出口法令，办理必要的相关手续。
7. 严禁将本资料记载的产品用于以及提供(出口)于开发大规模杀伤性武器或军事用途。对于如提供(出口)给开发、制造、使用或储藏核武器、生物武器、化学武器及导弹，或有其他军事目的者的情况，本公司对此概不承担任何责任。
8. 本资料记载的产品并非是设计用于可能对人体、生命及财产造成损失的设备或装置的部件(医疗设备、防灾设备、安全防范设备、燃料控制设备、基础设施控制设备、车辆设备、交通设备、车载设备、航空设备、太空设备及核能设备等)。本公司指定的车载用途例外。上述用途未经本公司的书面许可不得使用。本资料所记载的产品不能用于生命维持装置、植入人体使用的设备等直接影响人体生命的设备。考虑使用于上述用途时，请务必事先与本公司营业部门商谈。
本公司指定用途以外使用本资料记载的产品而导致的损害，本公司对此概不承担任何责任。
9. 半导体产品可能有一定的概率发生故障或误工作。
为了防止因本公司产品的故障或误工作而导致的人身事故、火灾事故、社会性损害等，请客户自行负责进行冗长设计、防止火势蔓延措施、防止误工作等安全设计。并请对整个系统进行充分的评价，客户自行判断适用的可否。
10. 本资料记载的产品非耐放射线设计产品。请客户根据用途，在产品设计的过程中采取放射线防护措施。
11. 本资料记载的产品在一般的使用条件下，不会影响人体健康，但因含有化学物质和重金属，所以请不要将其放入口中。
另外，晶元和芯片的破裂面可能比较尖锐，徒手接触时请注意防护，以免受伤等。
12. 废弃本资料记载的产品时，请遵守使用国家和地区的法令，合理地处理。
13. 本资料中也包含了与本公司的著作权和专有知识有关的内容。
本资料记载的内容并非是对本公司或第三方的知识产权、其它权利的实施及使用的承诺或保证。严禁在未经本公司许可的情况下转载或复制这些著作物的一部分，向第三方公开。
14. 有关本资料的详细内容，请向本公司营业部门咨询。

1.0-2016.01